



Title of Change:	Capacity Expansion of Assembly and Test operations of Cebu former Fairchild SOT23 package to ON Semiconductor Leshan, China and addition site of the backmetal to ON Niigata, Japan.	
Proposed first ship date:	2 August 2019	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Joan.Abigail.Enriquez@onsemi.com>	
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <ChangKit.Mok@onsemi.com>	
Type of notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Change Part Identification:	Customer may receive the parts from ON Semiconductor Leshan, China from month of June 2019 onwards once FPCN expire. Parts from ON Semiconductor Leshan, China can be identified through product marking which follow ON Semiconductor marking format.	
Change Category:	<input checked="" type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input checked="" type="checkbox"/> Assembly Change <input checked="" type="checkbox"/> Test Change <input type="checkbox"/> Other _____	
Change Sub-Category(s):	<input checked="" type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input checked="" type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input checked="" type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input type="checkbox"/> Other: _____	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Leshan, China (Assembly & Test Site) ON Cebu, Philippines (Assembly & Test Site)	External Foundry/Subcon Sites: None
Description and Purpose:		
	Current Site Information	Expansion Site Information
LeadFrame	Ag Plated LF	Cu Plated LF
Mold Compound	CK5000A EDALE ELER-8-100HFE	Hysol GR640HV
Assembly Site	ON Cebu, Philippines	ON Leshan, China
Testing Site	ON Cebu, Philippines	ON Leshan, China
BGBM Site	ON Bucheon, Korea	ON Niigata, Japan
Back metal	Ti Ni Ag Tin Back metal	Gold Back metal
Case outline	318BM	318-08
Product marking change	Ex-FCS Format	ON Semiconductor format

**Reliability Data Summary:**

DEVICE: BSS123-G, BSS138-G, FDV305N, NDS0610-G

RMS: P48559, S48560, F48537, P48561

PACKAGESOT23-3L

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated BV	1008 hours	0/462
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hours	0/462
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hours	0/462
PC	J-STD-020 / JESD-A113	MSL 1 @260°C		
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cycles	0/462
H3TRB + PC	JESD22-A101	Ta=85°C, 85% RH, 80% max rated BV	1008 hours	0/462
uHAST + PC	JESD22-A118	Ta=130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hours	0/231
ACLV + PC	JESD22-A102	Ta=121°C, 100% RH, 15psig, unbiased	96 hours	0/231
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/60
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/90

Electrical Characteristic Summary:

The temperature characterization and ESD performance meet datasheet specification. Detail of Electrical characterization result is available upon request.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
BSS84	NDS0610-G /BSS138-G
BSS84-G	NDS0610-G /BSS138-G
FDV305N	FDV305N
NDS0605	NDS0610-G /BSS138-G
NDS0610-G	NDS0610-G
BSS138-G	BSS138-G
BSS123-G	BSS123-G
2N7002-G	BSS123-G / BSS138-G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22578X

発行日 : 26 April 2019

変更件名:	セブにおける以前の Fairchild SOT23 パッケージの組み立ておよびテストオペレーションのオン・セミコンダクター楽山(中国)への能力拡大と、バックメタルの拠点としてオン新潟(日本)の追加	
初回出荷予定日:	2 August 2019	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Joan.Abigail.Enriquez@onsemi.com> にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または <ChangKit.Mok@onsemi.com> にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> 宛てにお願いします。	
変更部品の識別:	お客様はオン・セミコンダクター楽山(中国)製品を、FPCN の有効期限切れ後の 2019 年 6 月以降受け取ることができます。オン・セミコンダクター楽山(中国)製品は、オン・セミコンダクターのマーキングフォーマットに準拠した製品マーキングにより識別できます。	
変更カテゴリ:	<input checked="" type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input checked="" type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input checked="" type="checkbox"/> 試験の変更 <input type="checkbox"/> その他 _____	
変更サブカテゴリ:	<input checked="" type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input checked="" type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input checked="" type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> その他: _____	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: ON Leshan, China (組み立て拠点 & テスト拠点) ON Cebu, Philippines (組み立て拠点 & テスト拠点)	外部製造工場 / 下請業者拠点: なし
説明および目的:		
	現在の拠点情報	拡張後の拠点情報
リードフレーム	Ag メッキリードフレーム	Cu メッキリードフレーム
モールド・コンパウンド	CK5000A EDALE ELER-8-100HFE	Hysol GR640HV
組み立て拠点	ON Cebu, Philippines	ON Leshan, China
テスト拠点	ON Cebu, Philippines	ON Leshan, China
BGBM 拠点	ON Bucheon, Korea	ON Niigata, Japan
バックメタル	Ti Ni Ag Tin のバックメタル	金のバックメタル
ケースアウトライン	318BM	318-08
製品マーキング変更	Ex-FCS フォーマット	オン・セミコンダクター フォーマット



信頼性データの要約:

デバイス名: BSS123-G, BSS138-G, FDV305N, NDS0610-G
 RMS: P48559, S48560, F48537, P48561
 パッケージ: SOT23-3L

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated BV	1008 hours	0/462
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hours	0/462
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hours	0/462
PC	J-STD-020 / JESD-A113	MSL 1 @260°C		
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cycles	0/462
H3TRB + PC	JESD22-A101	Ta=85°C, 85% RH, 80% max rated BV	1008 hours	0/462
uHAST + PC	JESD22-A118	Ta=130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hours	0/231
ACLV + PC	JESD22-A102	Ta=121°C, 100% RH, 15psig, unbiased	96 hours	0/231
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/60
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/90

電気的特性の要約:

温度特性と ESD 性能はデータシートの規格に適合します。電気的特性評価結果の詳細は、要求に応じて入手可能です。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
BSS84	NDS0610-G / BSS138-G
BSS84-G	NDS0610-G / BSS138-G
FDV305N	FDV305N
NDS0605	NDS0610-G / BSS138-G
NDS0610-G	NDS0610-G
BSS138-G	BSS138-G
BSS123-G	BSS123-G
2N7002-G	BSS123-G / BSS138-G

Appendix A: Changed Products

D

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle
BSS84		NDS0610-G /BSS138-G
FDV305N		FDV305N
NDS0605		NDS0610-G /BSS138-G